

高通 MSM8909 智能平台 4G 系列模块

本系列模块采用高通 MSM8909 智能芯片平台，拥有 LCC/Mini PCI 两种封装。LCC 封装的 830 型号模块为运行安卓 5.1 操作系统的智能模块，可深度定制开发相关功能。模块可应用于 MID、车载设备、智能电/水表、远程控制/抄数、物体追踪、无线 POS 支付、安防监控、医疗护理等领域。

产品展示



产品详情



Qualcomm MSM8909 4G 智能平台通信模块			
型号		CLM920-EC5	CLM920-830
芯片		Qualcomm MSM8909	
封装类型		Mini PCIE	LCC
尺寸 (mm)		51*30*4.6	50*35*2.8
FDD-LTE 150M DL & 50M UL @Cat.4	B1	●	●
	B3	●	●
TDD-LTE 112M DL & 10M UL @Cat4	B38	●	●
	B39	●	●
	B40	●	●
	B41	●	●
WCDMA 42M DL & 5.76M UL	B1	●	●
	B3	●	●
TD-SCDMA 4.2M DL & 2.2M UL	B34/B39	●	●
CDMA 3.1M DL & 1.8M UL	BC0	●	●
GSM 236Kbps DL & UL	Quad-band	●	●
GPS		可选	
模拟语音		可选	
数字语音		●	
USB(2.0 High Speed)/UART/USIM		●	
NDIS/ECM/Gobinet		●	
SMS		●	
Network protocol		MMS/TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/SMTP	
操作系统支持		Windows/WIN CE/Linux/Android 4.0-6.0	
工作温度		-40°C~80°C	
工作电压		3.3-4.2V; 推荐 3.7V	
工作电流		关机<50uA；待机<7mA；最大平均 1000mA	